

TSSOP-SMD Multiadaptador (thin shrink small outline package)



RE933



- epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- lado de soldadura y de componentes con na superficie de oro químico y una máscara inhibidora de soldadura
- agujeros Ø 1,00 mm
- adaptador para 10 TSSOP diferentes
- pitch 0,65 mm / 0,50 mm
- puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- tamaño 58,90 x 120,10 mm

No.	Pitch	mil	Pin	Tamaño (mm)
RE933-01	0,65	22,5	8	4,4 (173 mil)
RE933-02	0,65	22,5	14	4,4 (173 mil)
RE933-03	0,65	22,5	16	4,4 (173 mil)
RE933-04	0,65	22,5	20	4,4 (173 mil)
RE933-05	0,65	22,5	24	4,4 (173 mil)
RE933-06	0,65	22,5	28	4,4 (173 mil)
RE933-07	0,65	22,5	32	6,1 (240 mil)
RE933-08	0,50	19,6	38	4,4 (173 mil)
RE933-09	0,50	19,6	48	6,1 (240 mil)
RE933-10	0,50	19,6	56	6,1 (240 mil)